【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年12月10日(2020.12.10)

【公開番号】特開2020-170872(P2020-170872A)
【公開日】令和2年10月15日(2020.10.15)
【年通号数】公開・登録公報2020-042
【出願番号】特願2020-119949(P2020-119949)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　21/306　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　21/306　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月27日(2020.10.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
基板処理槽で基板にエッチング処理を行うリン酸処理液に混合されるＳｉＯ２析出防止剤を供給するＳｉＯ２析出防止剤供給部と、
前記ＳｉＯ２析出防止剤の供給量を制御する制御部と
を備え、
前記制御部は、
前記ＳｉＯ２析出防止剤が前記リン酸処理液に混合されていない状態で、前記基板にエッチング処理が行われ、前記リン酸処理液のシリコン濃度が所定シリコン濃度以上になると、前記ＳｉＯ２析出防止剤を供給する
ことを特徴とする基板処理装置。
【請求項２】
前記制御部は、
前記エッチング処理の処理時間に基づいて前記ＳｉＯ２析出防止剤の供給量を制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の基板処理装置。
【請求項３】
前記制御部は、
前記リン酸処理液に含まれるＳｉＯ２析出防止剤濃度を検出し、
検出された前記ＳｉＯ２析出防止剤濃度に基づいて前記ＳｉＯ２析出防止剤の供給量を制御する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の基板処理装置。
【請求項４】
前記基板処理槽から排出された排気ガス中の酸系物質を除去する酸系処理部と、
前記基板処理槽から排出された排気ガス中の有機系物質を除去する有機系処理部と
を備えることを特徴とする請求項１から３のいずれか一つに記載の基板処理装置。
【請求項５】
並列に配設された前記酸系処理部または前記有機系処理部に、前記排気ガスを選択的に流入させる切替部
を備えることを特徴とする請求項４に記載の基板処理装置。
【請求項６】

基板処理槽にＳｉＯ２析出防止剤が混合されていない第１エッチング液を供給し、前記第１エッチング液を用いて、基板に対してエッチング処理を行う第１エッチング処理工程と、
前記第１エッチング液のシリコン濃度が予め設定された所定シリコン濃度以上となるときに、前記第１エッチング液に前記ＳｉＯ２析出防止剤を混合した第２エッチング液を用いて、前記基板に対してエッチング処理を行う第２エッチング処理工程と
を含むことを特徴とする基板処理方法。
【請求項７】
前記第１エッチング処理工程の開始から予め設定された処理時間が経過したときに、前記第１エッチング液のシリコン濃度が予め設定された所定シリコン濃度以上となったと判定すること
を特徴とする請求項６に記載の基板処理方法。
【請求項８】
請求項６または７に記載の基板処理方法をコンピュータに実行させる、プログラム。